

# メイショウ リボールの受託サービス来春開始

表面実装(SMT)の商社兼メーカーのメイショウ(東京都杉並区)は、半導体パッケージの不具合を修正するリワーク装置やリボール装置を自社開発してきた。高付加価値部品の再利用を促すために、半導体パッケージのBGA(ボール・グリッド・アレイ)リボールの受託サービスを来春から開始する。SDGs(持続可能な開発目標)の流れをくみ、リボール市場の拡大をにらむ。

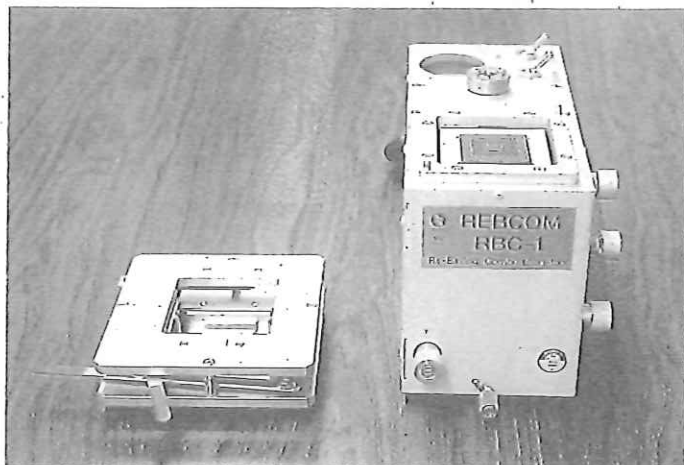
## 高付加価値部品の再利用促す



社長 川杉 長

積が小さい。そのに伴う供給不足や価格高騰が懸念される中で、多機能化、小型化に伴い、需要増加が予測される。川杉敦子社長は「基板の再利用と同時に、取り外した部品の再利用も考えている。SDGsの観点から、BGAに球状の部品を付け直す作業を流れてリボールが乗っついていく」と話す。

現在、リボールの受託のためにラインを青



リボール装置「リボコンRBC」

梅事業所(東京都瑞穂町)に構築中で、サービスは来春から開始する。リボールのラインは①リワーク装置で取り外したBGAボールの懸念があり、残渣

(ざんさ)の洗浄が必ず必要になる。フラックスレスのはんだ付けのため、ギ酸還元方式を採用し、品質への信頼性を追求する構えだ。当面、リボール装置にはリボコンを採用する計画だ。BGAは実装するツチ操作で部品の位置合わせができ、作業時と、はんだ接合部が隠れてしまう。実装不良を低減させているが、手作業の装置だ。このリボコンを全自動化することを、信頼性の向上を図り、安全性に厳しい車載関係や航空関係からのBGAリボールの受託も見込む。川杉社長は「高品質を追求し、これまでリボールを控えていた分野にPRしていきたい」と意気込む。ラインはショールーム化し、顧客に訴求する方針で、リボールの機器、設備ライン自体の販売につなげていく構えだ。



リボールのラインを組む青梅事業所

IT化の流れの中で、さまざまな製品に半導体が組み込まれていく現状や、SDGsの流れを踏まえ、同社はリワークやリボールの市場拡大を展望している。